

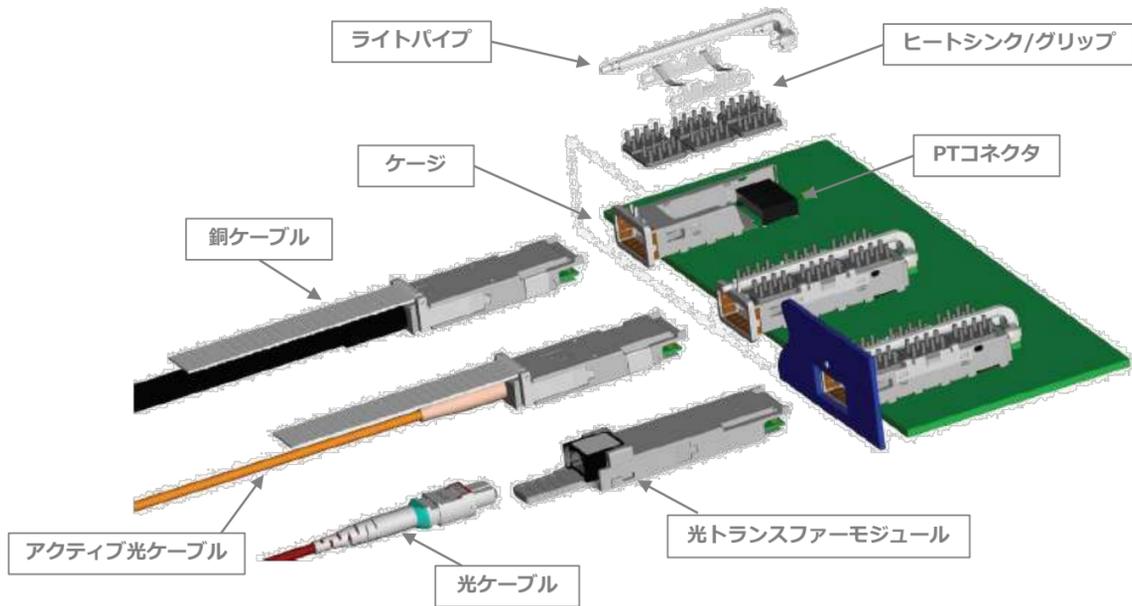


[データアンドデバイス製品レター]

高速I/Oコネクタソリューション

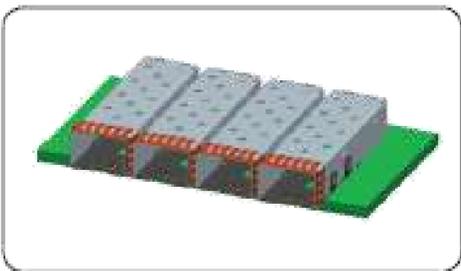
速度、小型化及び標準化を考慮して設計されたTEのI/Oコネクタは、重要なシステムの熱性能や通信用途における伝送特性を向上させるために、信頼性の高いソリューションを提供します。

■ I/Oインターフェースコンポーネント

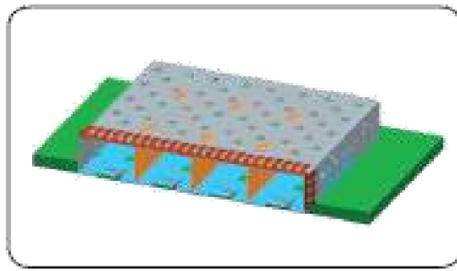


■ ケージポート構成

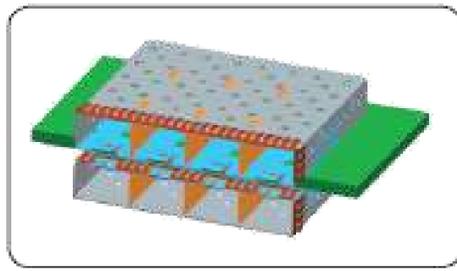
Single Port



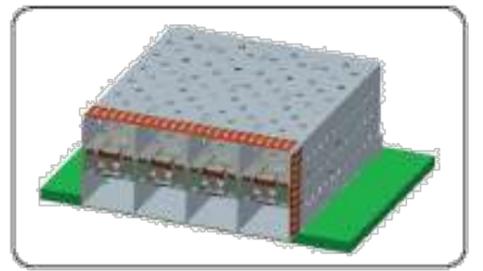
Ganged



Belly-to-Belly



Stacked



■ EMI機能

EMIスプリング



- ・低コスト。
- ・ベゼルへの圧力が少ない。

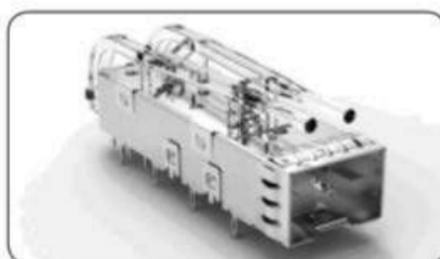
EMIガスカート



- ・高EMI特性。
- ・破損しにくい。
- ・基板端とベゼル間の寸法を厳しく管理する必要がある。

■ 周辺機器

ライトパイプ



- ・基板上的LEDの光を、ケージ天面にクリップで装着されたライトパイプを通して、嵌合側に光信号を表示することが可能。

ヒートシンク



- ・モジュールへの直接接続で、熱源から熱を放射。ヒートシンクは、3つのスタンダードのNET、SAN及びPCIがあり、また要求に合わせて設計が可能。



■ 製品ラインナップ

SFP



- ・最大4Gb/s のデータ伝送速度をサポート。
- ・20 ポジション PT (トランシーバ) コネクタ。
- ・単一ポート、ギャング、スタックタイプなどをラインナップ。

SFP+



- ・最大16Gb/s のデータ伝送速度をサポート。
- ・20 ポジション PT (トランシーバ) コネクタ。
- ・コネクタとケーブルアセンブリは SFP との互換が可能。

zSFP+



- ・最大28Gb/s のデータ伝送速度をサポート。
- ・20 ポジション PT (トランシーバ) コネクタ。
- ・コネクタと1xN ケーブルは SFP+ との互換が可能。

QSFP/QSFP+



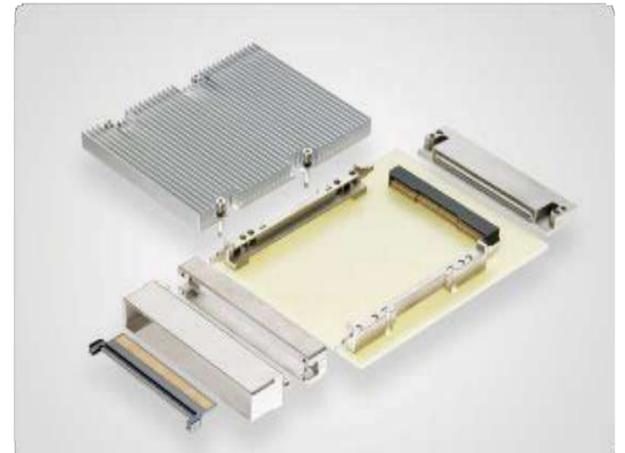
- ・最大40Gb/s (チャンネルあたり10Gb/s) のデータ伝送速度をサポート。
- ・従来の SFP3 倍のポート密度を実現した4 チャンネルパッケージ。
- ・38 ポジションの SMT コネクタ

zQSFP+



- ・最大100Gb/s (チャンネルあたり28Gb/s) のデータ伝送速度をサポート。
- ・プレスフィットピンのレイアウトで belly-to-belly の ケーブルポート構成を実現。
- ・QSFP+ との嵌合互換が可能。

CFP



- ・最大100Gb/s (チャンネルあたり10Gb/s) のデータ伝送速度をサポート。
- ・イーサネットの長距離伝送をサポート。
- ・148 ポジションの相互接続。
- ・優れた EMI シールドを実現。

CFP/CFP4



- ・最大レーンあたり28Gb/s、ポートあたり100Gb/s のデータ伝送速度をサポート。
- ・19 インチラインカードあたり CFP の最大4倍のデータレートを実現

QSFP-DD



- ・28 Gbps NRZ または 56 Gbps PAM-4 に対応。
- ・8レーンで QSFP の2倍のポート密度で、200 または 400 Gbps のデータ伝送速度をサポート。
- ・QSFP モジュールとの嵌合互換が可能。

サーマルブリッジテクノロジー



- ・プレート構造で、ヒートシンクとのギャップがほぼゼロにし、熱伝導の最適化を実現。
- ・弾性圧設計を採用することにより、圧縮力を低減させ、長期的な熱性能の安定化を実現。

インターネット [TE.com](http://te.com) に図面、仕様書をご用意しております。 <http://te.com>